第四节董事会报告一、概述2013年在全球经济继续缓慢复苏的影响下，全球半导体市场增速周期性回升，市场规模达到3,056亿美元，市场增速为4.8%。受利于全球经济形势的好转、我国电子整机产品出口需求的增加，以及移动互联设备的快速增长，我国集成电路产业增长强劲。根据中国半导体行业协会统计，2013年我国集成电路产业销售额为2,508.6亿元，同比增长16.2%，集成电路产量为876.6亿只，同比增长5.4%，其中集成电路封装测试业销售额1,098.9亿元，同比增长6.1%。2013年公司通过募集资金投资项目和研发项目的有效实施，集成电路封装能力和技术水平都得到了快速提高；并进一步强化内部管理，加大成本控制和市场开发，使得2013年公司经营业绩大幅增长，公司盈利能力和综合竞争能力显着提升，保持了良好快速发展势头。1、经营业绩大幅提升。全年共完成集成电路封装量83.70亿只，同比增长20.85%，实现营业收入24.47亿元，同比增长50.76%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长64.55%。2、技术研发稳步推进。通过国家科技重大专项02专项等研发项目的实施，开发出了FC系列先进集成电路封装技术和产品，具备了FC仿真设计和工程批能力，并进行了高深宽比TSV技术和阵列模组的研发。3、产业布局日趋完善。完成了昆山公司28.85%股权收购，使公司持有昆山公司的股权达到63.85%。2013年，昆山公司扭亏为盈，实现净利润3,241.61万元，西安公司实现快速增长，完成营业收入4.72亿元，实现净利润5,136.19万元，分别同比增长98.07%、143.82%。形成了天水、西安、昆山三地共同发展的良好格局。4、LED业务初具规模。顺利完成了LED封装线的组建，成功开发出SMD3014、SMD5050、SMD2835、SMD3528等LED封装产品，以及T5/T8灯管、面板灯和3～12W的各种球泡灯,并具备了规模生产能力。5、矿业开发取得突破。矿业公司成功竞得“甘肃省肃北蒙古族自治县西尖山北金矿普查”探矿权，为公司寻找新的业务增长点打开了新局面。6、可转债顺利发行。公司4.61亿元可转债于2013年8月成功发行并上市，募集资金总额104.61亿元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为4.51亿元，为投资项目的实施和实现公司战略目标奠定了良好的基础。二、主营业务分析1、概述2013年公司主营业务为集成电路封装测试，全年实现营业收入24.47亿元，同比增长50.76%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长64.55%。单位:元变动原因分析：（1）营业收入和营业成本分别比上期同比增长50.76%和45.80%，主要原因是本报告期产能较上期稳步增长，产能利用率不断提高；本期财务报表合并范围变化，新增加华天科技（昆山）电子有限公司，公司的营业收入和营业成本较上期增加。（2）管理费用比上期同比增长51.04%，主要原因是本报告期管理人员薪酬、研发支出较上年同期增加，本报告期合并范围增加所致。（3）财务费用比上期同比增长57.07%，主要原因是本报告期利息支出较上年同期增加。（4）研发支出比上期同比增长42.09%，主要原因是公司加大了技术研发项目的实施力度，新产品、新技术、新工艺开发支出增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司在2012年年度报告中披露的公司2013年度生产经营目标为全年实现营业收入19亿元。2013年公司紧紧围绕全年的生产经营目标，通过各项工作的有效开展，很好的完成了2012年年度报告中预定的经营计划。（1）全面完成了“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目的实施，使公司的集成电路年封装能力达到了90亿只。（2）进一步加大科研投入力度，全年研发投入共计1.45亿元，同比增长42.09%。开发出了FCQFN/FCDFN系列封装产品7种，FCBGA/FCCSP系列封装产品5种，AAQFN系列封装产品7种，具备了FC仿真设计和工程批能力，进行了高深宽比TSV技术和阵列模组的研发。11（3）加大海外市场开发力度，2013年出口营业收入9.68亿元，同比增长88.60%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用2、收入说明报告期内，公司完成集成电路封装量83.70亿只，销售集成电路封装产品83.38亿只，实现营业收入24.47亿元，同比上期分别增长20.85%、20.13%、50.76%，主要原因是随着“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目的实施完成，公司集成电路封装能力稳步提高，项目产能不断释放，公司集成电路封装量和销售量稳定增长。2013年9月昆山公司纳入公司财务报表合并范围，因本次合并公司2013年新增营业收入2.27亿元，占营业总收入的9.26%。公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用公司集成电路库存量较上年同比增长36.68%，主要原因是公司集成电路封装能力提高，而使得公司单日集成电路封装量增加所致。公司重大的在手订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况12□适用√不适用公司主要销售客户情况公司前5大客户资料√适用□不适用3、成本行业分类单位：元产品分类单位：元说明报告期内公司主营业务成本占营业成本的99.35%，较上年同期增长46.11%，主要原因为13公司集成电路封装能力和产量较上年增加，以及昆山公司2013年9月纳入公司财务报表合并范围所致。公司主要供应商情况公司前5名供应商资料√适用□不适用4、费用单位:元（1）销售费用较上年同期增长32.73%，主要是本报告期营业收入增长，产品运输费和业务费较上年同期增加；（2）管理费用较上年同期增长51.04%，主要是本报告期管理人员薪酬、研发支出较上年同期增加，本报告期合并范围增加所致；（3）财务费用较上年同期增长57.07%，主要是本报告期利息支出较上年同期增加；（4）所得税费用较上年同期增长49.99%，主要是本报告期利润总额较上年同期增加。5、研发支出14单位:元报告期内，公司所实施的国家科技重大专项02专项等科技创新和研发项目，是为了自主开发出多项集成电路先进封装技术和产品。通过研发项目的实施，将不断开发出更多的集成电路先进封装技术和产品，有效地提高公司的自主创新能力和核心竞争能力，满足市场和客户需求，实现公司的长远发展。6、现金流单位：元相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用变动原因：（1）经营活动产生的净现金流量同比增长80.72%，主要是公司营业收入增长和回款增加及合并昆山公司所致；（2）投资活动产生的净现金流量同比增长234.78%，主要是本期购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金和办理定期存单较上期有较大增长所致；（3）筹资活动产生的净现金流量同比增长604.01%，主要是本期发行可转债募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明15□适用√不适用三、主营业务构成情况单位：元公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况16单位：元2、负债项目重大变动情况单位：元3、以公允价值计量的资产和负债单位：元报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否五、核心竞争力分析1、成本优势17公司地处西部地区具有较低的人力资源成本，土地使用、生产动力等方面的价格也相对较低，使公司具有国外以及国内沿海地区集成电路封装企业所无法比拟的成本优势。随着公司集成电路封装规模的不断扩大以及成本管控的持续开展，公司在成本方面的竞争优势将进一步得到加强和巩固。2、技术优势公司依托国家级企业技术中开发，自主研心、甘肃省微电子工程技术研究中心、甘肃省微电子工程实验室等研发验证平台，通过承担国家科技重大专项02专项等科技创新项目以及新产品、新技术、新工艺的不断研究发出BGA、FCBGA/FCCSP、FCQFN/FCDFN、U/VQFN、AAQFN、MCM（MCP）、SiP、TSV等多项集成电路先进封装技术和产品，随着公司进一步加大技术创新力度，公司的技术竞争优势将不断提升。3、市场优势公司拥有稳定的客户群体和强大的销售网络，通过多年的合作，公司得到了客户的广泛信赖，为公司发展提供了有力的市场保证，降低了市场风险。今后，公司在稳定扩展国内市场的同时，进一步加大海外市场的开发力度，促进公司持续快速发展。4、管理团队优势公司拥有一支善于经营、敢于管理、勇于开拓创新，团结向上的经营管理团队；公司法人治理结构完善，各项管理制度齐全；多年的大生产实践，公司已形成了一套先进的大生产管理体系。六、投资状况分析1、对外股权投资情况对外转让，18（1）对外投资情况零配件及技术的进口业务。数量（股）（2）持有金融企业股权情况2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况19单位：万元1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年10月以非公开的方式发行人民币普通股（A股）32,900,000股（每股面值1元），每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为365,848,000.00元，扣除各项发行费用15,330,000.00元后，募集资金净额为人民币350,518,000.00元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]703A173号《验资报告》。2、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，公司募集资金的具体管理情况如下：2011年11月4日，公司与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2011年11月7日，公司通过募集资金专户向西安公司增资13,300.00万元，用于其进行募集资金投资项目“集成电路高端封装测试生产线技术改造项目”建设。西安公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2011年11月8日与昆仑银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。募集资金总额为35,051.80万元，报告期投入募集资金总额为0.01万元，截至2013年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为35,201.56万元，其中：募集资金存款利息累计为149.76万元，募集资金专项账户金额已全部使用完毕。二、2013年公开发行可转换公司债券募集资金情况1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2013年8月12日向社会公开发行461万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额461,000,000.00元，并于2013年8月28日在深交所上市。本次公开发行可转债募集资金总额为461,000,000.00元，扣除发行费用9,666,500.00元后的实际募集资金净额为451,333,500.00元。该募集资金已于2013年8月16日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第209A0002号《验资报告》。2、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，公司募集资金的具体管理情况如下：2013年8月28日，公司与中国光大银行兰州分行营业部、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》。公司对可转债募集资金实行专户存储，并对可转债募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2013年9月2日，公司通过募集资金专户向西安公司增资15,000.00万元，用于其进行募集资金投资项目“40纳米集成电路先进封装测试产业化项目”建设。西安公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2013年9月4日与中国光大银行西安雁塔路支行和第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，对可转债募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止，《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。募集资金总额为45,133.35万元，报告期投入募集资金总额为26,363.62万元，截至2013年12月31日，公司累计使用20募集资金26,363.62万元，其中：募集资金存款利息累计为112.01万元，募集资金专项账户余额为18,881.74万元。（2）募集资金承诺项目情况21单位：万元超募资金的金额、3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况22单位：元、自动化设备、主要子公司、参股公司情况说明23（1）华天科技（西安）有限公司为公司全资子公司，2013年实现营业收入4.72亿元，同比增长98.07%，实现净利润5,136.19万元，同比增长143.83%。西安公司“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目在本年度全面实施完成，集成电路封装产能和产销量大幅提升，项目经济效益逐步释放。（2）华天科技（昆山）电子有限公司为公司控股子公司，公司持有昆山公司63.85%的股权，从2013年9月起纳入公司财务报表合并范围。2013年昆山公司完成营业收入7.56亿元，实现净利润3,241.61万元。（3）天水中核华天矿业有限公司为公司控股子公司，公司持有矿业公司70%的股权，是公司为了形成新的业务增长点而与甘肃省核地质二一九大队合资设立。2013年7月，矿业公司以人民币420万元竞得“甘肃省肃北蒙古族自治县西尖山北金矿普查”探矿权，并根据要求由矿业公司在探矿权所在地注册成立了全资子公司酒泉中核华天矿业有限公司。目前，以酒泉中核华天矿业有限公司的名义正在办理“甘肃省肃北蒙古族自治县西尖山北金矿普查”探矿权勘查许可证。报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用、4、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元七、公司未来发展的展望1、行业竞争格局和发展趋势（1）行业竞争格局24目前国内集成电路封装测试业的企业构成明显呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，由飞思卡尔（Freescale）、英特尔（Intel）、松下（Panasonic）、意法半导体（ST）、瑞萨（Renesas）、英飞凌（Infineon）、日月光（ASE）等国际大型半导体企业在华投资设立的封装测试企业，无论在规模上还是在技术水平上都居主导地位。近几年来，国内集成电路封装企业不断加大技术改造和技术研发，产业规模不断扩大，封装技术水平快速提高，集成电路高端封装技术已逐步接近和达到国际先进水平。未来随着我国集成电路产业的整体快速发展和国家对集成电路产业扶持力度的不断加大，国内集成电路封装企业将加速发展，国内集成电路封装企业与国际半导体企业之间正逐步开始面对面的竞争。（2）发展趋势基于集成电路对国民经济和国家安全的高度重要性，我国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项优惠措施。目前国家正在积极酝酿集成电路产业投资新政，新政出台后将进一步促进我国集成电路产业的快速发展。未来，战略性新兴产业将成为推动我国集成电路产业发展的新动力，并且随着智能移动终端、可穿戴设备、物联网等集成电路应用领域的不断拓展，将带动集成电路产业进入新一轮的快速发展时期，根据中国半导体行业协会（CSIA）、中国电子信息产业发展研究院（CCID）预计，2014年～2016年，我国集成电路销售收入年均增速超过13%，2016年达到3,739.56亿元。顺应集成电路产品向功能多样化的发展趋势，BGA、CSP、MCM、WLP、FC、3D、TSV等先进封装产品和技术将是今后集成电路封装发展的重点。2、未来发展战略公司将坚持以发展为主题，以科技创新为动力，以产品结构调整为主线，倡导管理创新、产品创新和服务创新，在扩大和提升现有集成电路封装业务规模与水平的同时，大力发展BGA、CSP、MCM（MCP）、SiP、FC、TSV、MEMS、LED等高端封装技术和产品，扩展公司业务领域，提升核心业务的技术含量与市场附加值，进一步开拓海外市场。在引进高层次管理技术人才的同时，将着力培养、打造一支在研发、经营、管理和销售方面具有竞争优势的高素质、业务娴熟的骨干队伍，以持续不断的技术和产品创新，提高企业的核心竞争力，将公司发展成为国际知名的集成电路封装测试企业，打造中国封装测试行业的第一品牌。3、下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素分析（1）2014年度生产经营计划根据行业特点和市场预测，2014年度公司生产经营目标为全年实现营业收入30亿元，生产经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。公司2014年主要开展以下工作：①继续实施“40纳米集成电路先进封装测试产业化”项目和“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目，不断提高公司的集成电路封装能力。25②加快FC等系列已完成研发的集成电路高端封装产品和技术产业化进程，组建Bumping生产线，努力扩大集成电路高端封装产品封装规模。③继续推进国家科技重大专项02项项目以及其它先进封装技术和产品的研发工作，加快高深宽比TSV技术和阵列模组的研发进程，提高公司的技术水平和市场竞争能力。④进一步加大集成电路高端封装产品市场开发力度，不断提高集成电路高端封装产品占比和市场份额。（2）未来面对的风险因素分析①受半导体行业景气状况影响的风险公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。②产品生产成本上升的风险公司产品主要原材料的价格与黄金、铜的价格走势密切相关。如果黄金与铜的价格变化存在较大的波动，从而会导致公司经营业绩出现一定的波动。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。针对上述风险，公司未来将继续优化生产工艺流程，加大工艺升级力度，提高设备利用率；强化节能降耗和材料消耗管理，降低经营成本；提高生产自动化、信息化水平，增强公司的盈利能力和抗风险能力。③新产品开发与技术研发失败的风险集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快新产品开发和技术研发步伐，如果公司开发的新产品和技术研发能力不能够满足市场和客户的需求，公司将面临新产品开发与技术研发失败的风险。针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展热点和用户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。（3）发展规划资金需求、使用计划以及资金来源情况公司2014年发展规划资金需求主要为“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目和“40纳米集成电路先进封装测试产业化”项目实施所需资金，以及日常生产经营和技术产品研发以及市场开发等方面所需资金，资金来源主要为发行可转债的募集资金、自有资金及银行贷款。26八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。2013年2月22日，公司与深圳市汉迪创业投资有限公司签署了股权转让协议，公司拟受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山公司28.85%的股权。2013年8月底，昆山公司完成工商变更登记手续，深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山公司28.85%股权已过户到公司名下，公司共计持有昆山公司63.85%的股权。昆山公司自2013年9月起纳入公司财务报表合并范围。公司2013年财务报表因合并昆山公司财务报表，增加资产66,404.73万元、负债14,330.40万元、少数股东权益18,824.87万元；增加营业收入22,661.75万元、归属于母公司的净利润-1,681.94万元。十二、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用为了进一步完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，并有效执行。27根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定和要求，公司将于2014年6月30日前进一步修订完善公司利润分配政策，并制定未来三年股东回报规划。公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况（1）2011年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：以公司2011年12月31日的总股本406,130,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利40,613,000.00元。以公司2011年12月31日的总股本406,130,000股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股。公司总股本由406,130,000股增加为649,808,000股。（2）2012年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：以公司2012年12月31日的总股本649,808,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利32,490,400元。2012年度不进行资本公积转增股本。（3）2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案为：公司拟以2013年12月31日的总股本649,808,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利32,490,400.00元；由于公司发行的可转换公司债券自2014年2月17日开始转股，如果报告期末至分红派息股权登记日期间的总股本发生变动，利润分配按每10股分配现金红利0.50元（含税）为基准实施，调整分配现金红利总金额。2013年度不进行资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表单位：元公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案28□适用√不适用十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十四、社会责任情况公司积极履行社会责任，恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面认真执行国家的相关法律法规。1、公司通过了ISO14001：2004环境管理体系认证，产品生产过程符合国际国内绿色环保、安全生产要求，出口产品满足欧盟的ROHS标准。公司注重节能降耗和资源综合利用，生产废水经过回收处理二次使用并达标后进行排放，符合能源节约型、环境友好型社会要求。2、公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信息与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。293、公司倡导“以人为本”的管理思想，定期举办各类培训、岗位技能大赛，为员工提供学习机会和晋升通道。报告期内，公司完成OHSAS18001职业健康安全管理体系的建立，通过了BV公司审核并于11月份取得证书，有效与ISO14001环境管理体系并轨，形成完整的EHS管理体系。公司通过员工会员代表大会、表彰大会、文艺演出、排球比赛、羽毛球比赛、旅游、迎春年会等样式繁多的活动，丰富员工生活，坚持为员工进行免费体检，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。4、公司按照“以人为本、服务社会”的经营宗旨强调社会责任，以实际行动真诚回报社会。每年积极组织员工向天水市血站义务献血。积极响应省委、省政府“联村联户、为民富民”号召，深入对口联系点张家川县龙山镇南梁村进行帮扶，向甘肃漳县、岷县地震灾区和天水娘娘坝泥石流灾区等捐赠钱款43万元，切实履行了社会职责。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□是√否□不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□是√否□不适用报告期内是否被行政处罚30□是√否□不适用十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表